



平成 29 年 11 月 10 日

各 位

会 社 名 北 陸 電 気 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 津 田 信 治  
(コード番号 6989 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 下 坂 立 正  
(TEL. 076-467-1111 )

## 株式会社メイコーとの包括的業務提携に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社メイコーとの間で、包括的業務提携契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 包括的業務提携の理由

電子部品業界では自動車の部品電装化やEV化の進展、民生エレクトロニクスにおけるIoTへの対応、市場の更なるグローバル化など目まぐるしい市場の変化が起っており、これらの市場の変化に対応し、顧客のハイレベルな要求に応えながら、両社事業の発展を図っていくため、電子機器のモジュール実装事業を中心に、当社のセンサ・抵抗器事業、株式会社メイコーの電子回路基板事業など、関連会社を含む両社の経営基盤を有効に活用し、両社が協力して事業を行っていくことといたしました。

#### 2. 包括的業務提携の内容

現在、電子部品、特に電子機器のモジュール実装事業においては、顧客の地産地消等のニーズが高く、これに応える製品の供給体制等を実現するため、両社で生産提携を実施し、両社の製造拠点を相互に活用して顧客のニーズに応じていきます。

また、両社の営業網を有効活用して、市場の更なるグローバル化などに対応し、両社の売上を拡大していくため、販売提携を実施し、双方の顧客に対しての営業活動を行っていきます。

そして、これまで以上に顧客のハイレベルな要求を満たす機能、性能を持つモジュール製品などを開発していくため、両社が保有するモジュール実装事業の技術、当社が保有する高精度で信頼性の高いセンサ・抵抗器の技術、株式会社メイコーの高密度回路、高耐熱、高放熱、高周波などの優れた特徴を持つ電子回路基板の技術など、両社の保有する技術を活用し合って付加価値の高いモジュール製品などの共同開発を行っていきます。また、技術者の相互交流を実施し、技術およびノウハウを相互に有効活用し合っていきます。

### 3. 包括的業務提携の相手先の概要

(1) 名称	株式会社メイコー		
(2) 所在地	神奈川県綾瀬市大上 5-14-15		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 名屋 佑一郎		
(4) 事業内容	電子回路基板の設計・製造・販売、実装事業		
(5) 資本金	12,888 百万円		
(6) 設立年月日	昭和 50 年 11 月 25 日		
(7) 当社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません	
	人的関係	該当事項はありません	
	取引関係	当社が当該会社から電子回路基板を仕入れております	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません	
(8) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	平成27年3月期	平成28年3月期	平成29年3月期
連結純資産	38,622百万円	28,764百万円	28,540百万円
連結総資産	122,963百万円	109,605百万円	103,578百万円
1株当たり連結純資産	1,475.59円	897.97円	882.84円
連結売上高	90,895百万円	95,287百万円	95,911百万円
連結営業利益	△2,865百万円	3,325百万円	5,788百万円
連結経常利益	1,075百万円	△491百万円	2,981百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	△9,573百万円	△11,250百万円	1,767百万円
1株当たり連結当期純利益	△365.76円	△429.83円	54.14円
1株当たり配当金			
普通株式	—	—	10.00円
A種優先株式	—	—	7,000,000.00円

### 4. 日程

- (1) 取締役会決議日 : 平成 29 年 11 月 10 日  
(2) 契約締結日 : 平成 29 年 11 月 10 日

### 5. 今後の見通し

本業務提携が当期の業績に与える影響は軽微なものを見込んでおりますが、中長期的に当社の業績向上に資するものと考えております。今後、適時開示の必要性が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以上